

wafer切割 氮化硅氧化硅镀铜硅片激光划线开圆孔定制加工

产品名称	wafer切割 氮化硅氧化硅镀铜硅片激光划线开圆孔定制加工
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

wafer切割 氮化硅氧化硅镀铜硅片激光划线开圆孔定制加工，北京华诺激光切割加工，欢迎新老客户来电咨询。联系刘经理，将竭诚为您服务！！

激光硅片切割是电子行业硅基片又一新领域的应用。激光切割是利用高能激光束照射在工件表面,使被照射区域局部熔化、气化、从而达到划片的目的。因激光是经专用光学系统聚焦后成为一个非常小的光点，能量密度高，因其加工是非接触式的，对工件本身无机械冲击力，工件不易变形。热影响极小，划精度高，广泛应用于太阳能电池板、薄金属片的切割和划片。

硅片规格有多种分类方法，可以按照硅片直径：4寸、6寸、12寸、3英寸、2英寸；单晶生长方法：单晶硅片、多晶硅片；掺杂类型：N型、P型等参量和用途来划分种类。